

# 苏州纳芯微电子股份有限公司

## 投资者关系活动会议纪要

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动（券商策略会） <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会
参与单位名称	广发证券、招商证券、博时基金、交银人寿、银华基金、华夏基金、天弘基金、Millennium Capital、富邻投资、创金合信基金、东方红资管、东方阿尔法基金、中信保诚人寿、中国人寿资产、中欧基金、中科沃土、中邮基金、于翼资产、交银施罗德基金、前海人寿、前海开源基金、前海联合基金、华美国际、南土资产、国投瑞银基金、国泰基金、天安人寿、宁泉资产、建信养老、建信基金、拾贝投资、新华资产、易米基金、望正资产、正圆投资、泓澄投资、一创资管、玄元投资等
时间	2024年3月6日-8日
公司接待人员姓名	投资者关系总监 卢志奇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q:</b> 公司已经发布 23 年业绩快报，去年第四季度营收环比保持增长原因？以及下游各应用领域景气度趋势如何？</p> <p><b>A:</b> 去年第四季度营收环比增长约 12%，第四季度泛能源、汽车等领域营收均实现环比增长，主要是因为泛能源中传统工业、数字电源等领域需求有所恢复，汽车市场需求也保持环比稳健增长。下游应用景气度方面，传统工业和光伏市场在经历了去年的需求疲软和去库存后，需求开始逐步有所恢复，另外在汽车电子市场公司持续推出新产品，推动汽车电子领域营收有所增长。</p>

**Q: 随着成本端代工和封测价格有所改善, 后续毛利率趋势展望情况如何?**

A: 成本优化方面, 一方面是通过商务谈判来降低成本, 并取得了一些不错进展。上游的晶圆厂和封测厂都给予了公司有力的支持, 为公司提供了有竞争力的降价幅度。然而, 由于客户端的降价是立即生效的, 供应链的降价则需要生产周期和库存周期, 所以会有一些的滞后性。因此, 往后看供应链成本端的优化将逐步在毛利率上体现出来。

除了供应链成本优化之外, 公司还通过内部做了非常多的成本优化动作。通过产品设计和制程上的优化, 积极改善产品成本的构成, 通过设计与工程上的优化, 能进一步提升成本竞争力。随着这些成本优化的举措逐渐产生效果, 整个毛利率的状况应该会逐步得到更好的稳定或改善。

另外, 公司新产品仍在不断推出, 新产品毛利率普遍高于公司平均毛利率水平, 后续产品结构的不断优化也有望对毛利率产生正向影响。

**Q: 公司磁传感器的布局进展情况?**

A: 公司布局的磁类传感器产品包括磁电流传感器、磁角度传感器、磁开关传感器、磁轮速传感器等; 公司磁电流传感器从 22 年中开始量产, 23 年该品类营收主要来自于光伏应用市场, 24 年将有望逐步拓展至汽车三电系统应用, 成为 24 年磁类传感器营收的重要增量。同时, 磁角度和磁开关传感器等产品也将逐渐产生营收贡献。

**Q: 公司在隔离类产品方面有哪些新产品推出?**

	<p><b>A:</b> 带保护功能的隔离驱动产品已经在部分新能源车客户主驱应用中实现量产，并已经在 23 年产生不错的营收增量贡献，功能安全主驱隔离驱动产品预计 24 年量产推向市场，另外隔离驱动产品也在逐步替代光耦驱动，应用于光伏逆变器和工业电机驱动上，部分头部客户正逐步进行替代，并且不断提升份额，这也是隔离领域的增长点。</p> <p><b>Q:</b> 公司在电源管理方向的布局情况？</p> <p><b>A:</b> 车灯驱动方面，公司推出的单通道/三通道/12 通道尾灯 LED 驱动芯片已经导入汽车车灯头部客户，并且实现大规模出货；马达驱动方面，公司在 23 年第三季度也陆续量产了新一代隔离半桥驱动以及多路半桥马达驱动产品，并且开始逐步上量和贡献增量营收；供电电源 LDO 方面，公司已经实现部分客户的导入工作，24 年有望逐步贡献增量营收；功率路径保护方面，公司低边开关产品已经实现量产，高边开关相关产品将于 24 年实现量产。</p> <p><b>Q:</b> 公司在并购整合方面的思路和规划？</p> <p><b>A:</b> 我们一直在积极关注市场上并购和整合的机会，并购整合的整体思路是围绕汽车电子和泛能源等关键应用，构建核心的市场能力、产品能力和技术能力，不断拓宽产品品类，成为一家具有芯片级解决方案能力的半导体公司。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 11 日